

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
25. Juni 2015 (25.06.2015)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2015/091260 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B23K 35/26 (2006.01) *B23K 35/02* (2006.01)
B23K 35/36 (2006.01) *H05K 3/34* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2014/077559

(22) Internationales Anmeldedatum:
12. Dezember 2014 (12.12.2014)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
13197640.9 17. Dezember 2013 (17.12.2013) EP

(71) Anmelder: **HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG** [DE/DE]; Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau (DE).

(72) Erfinder: **NACHREINER, Jens**; Am Reitacker 17A, 36381 Schlichtern (DE). **WIESE, Joachim**; In den Schafhecken 14, 64739 Höchst/Odw. (DE). **FRITZSCHE, Sebastian**; Salisweg 30B, 63454 Hanau (DE).

(74) Anwalt: **HERAEUS HOLDING GMBH**; Intellectual Property, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: METHOD FOR SECURING A COMPONENT TO A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG EINES BAUTEILS AUF EINEM SUBSTRAT

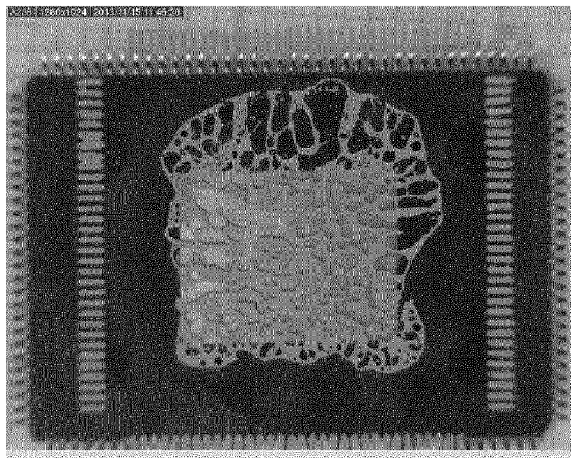


Fig. 2

(57) **Abstract:** The present invention relates to a method for securing an electronic component to a substrate, using a solder paste which contains a mixture of organic dicarboxylic acids, the thickness of the solder deposits being 25 to 200 μm .

(57) **Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Befestigung eines elektronischen Bauteils auf einem Substrat, unter Verwendung einer Lotpaste, die eine Mischung aus organischen Dicarbonsäuren umfasst und bei welchem die Dicke des Lotdepots 25 bis 200 μm beträgt.

WO 2015/091260 A1